

世界各国集成电路生产厂及命名方法

V1.0

1.AMERICAN MICROSYSTEMS

美国微系统公司

字头

器件

后缀

封装形式:

- P 塑料封装
- E 陶瓷双列直插
- C 陶瓷封装

S	2559A	P	
└─	└─	└─	
标准型	改进型	封装形式	

2.ANALOG DEVICES

美国模拟器件公司

字头

器件

后缀

封装形式:

- D 陶瓷双列直插
- F 陶瓷扁平
- H TO-5 金属封装
- N 塑料双列直插

温度范围:

- A.B.C 工业级
- J.K.L 商用级
- STU 军用级

AD	574	J	N
└─	└─	└─	└─
模拟器件	温度范围	封装形式	封装形式

3.CHERY SEMICONDUCTOR

美国齐瑞半导体器件公司
(Micro Components 微型元件)

字头

器件

后缀

封装形式:

- O 双引线
- D 双引线
- P 小球型封装
- T TO 型金属封装
- 4 四引线
- 8 八引线

CS	555	D8	
└─	└─	└─	
公司代号	产品序号	封装形式	

4.EXAR INTEGRATED SYSTEMS

美国埃克亚集成系统公司

字头

器件

后缀

封装形式:

- D 小方块型封装
- P 塑料封装
- N 陶瓷封装

器件等级:

- C 商用
- M 军用 (陶瓷封装) -55°C—+125°C

XR	567	C	P
└─	└─	└─	└─
标准型	产品序号	器件等级	封装形式

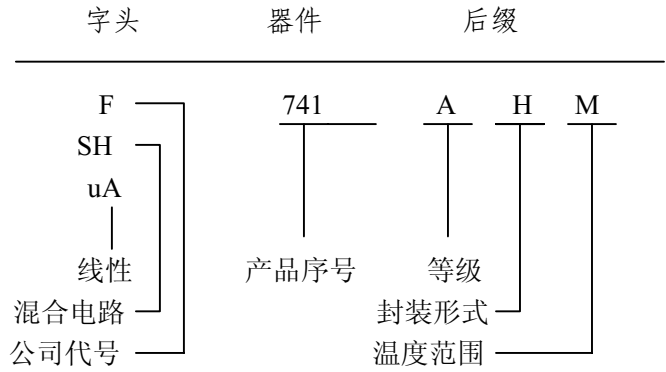
5. FAIRCHILD 美国仙童公司

封装形式:

- D 陶瓷双列封装
- E 塑料管脚
- P 扁平封装
- H 金属管脚
- J 金属功率封装 (TO-66)
- K 金属功率封装 (TO-3)
- P 塑料双列封装
- R 陶瓷小型双列直插封装
- T 小型双列直插
- U 功率封装 (TO-220)
- W 塑料封装 (TO-92)

温度范围:

- C 0°C—+70°C/75°C (CMOS→40°C—+85°C)
- L MOS -55°C—+85°C 混合-20°C—+85°C)
- M -55°C—+125°C



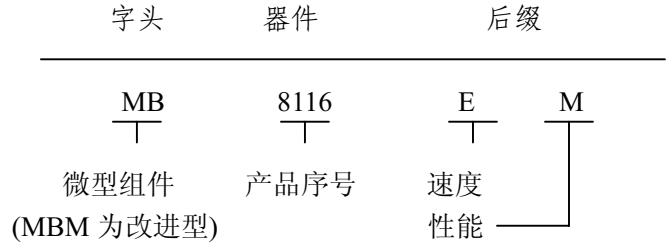
6. FUJITSU 日本富士通公司

封装形式:

- C 陶瓷封装
- M 标准塑料封装
- C 陶瓷双列直插封装

电路性能:

- N
- E
- H
- L 低功率



7. GENERAL INSTRUMENT 美国通用仪器公司

温度范围及工艺:

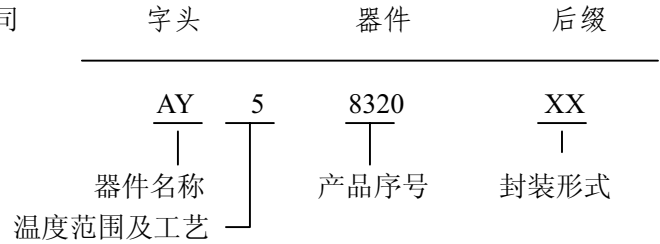
- D MTOS -55°C—+85°C
- 1 MTOS 0°C—+70°C
- 4 N沟
- 6 -55°C—+125°C

器件名称:

- AY 阵列电路
- LC 线性电路
- LG 逻辑电路

封装形式:

- 29 24 引脚塑料双列直插
(其他封装略)



8.HITACHI 日本日立公司

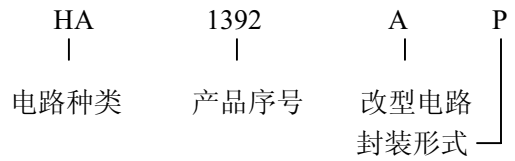
电路种类:

- HA 模拟电路
- HD 熟悉电路
- HM 存储器 (RAM)
- HN 存储器 (ROM)

封装形式:

- P 塑料封装

字头 器件 后缀



9.INTERSIL 美国英特西尔公司

电路种类:

- D 驱动器
- DG 模拟开关
- ICL 线性电路
- ICM 手表及时钟电路

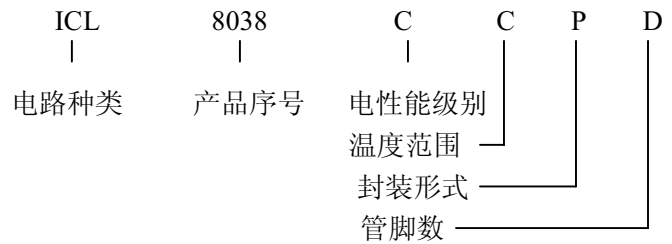
温度范围:

- A -55°C—+125°C
- B -20°C—+85°C
- C 商用级 (0°C—+70°C)
- I 工业级 (-40°C—+85°C)
- M 军用级 (-55°C—+125°C)

封装形式:

- B 塑料扁平 (小型)
- D 陶瓷双列直插
- E 小型 TO-8 型
- F 陶瓷扁平
- L 无引线、陶瓷
- T TO-5 型
- (其它略)

字头 器件 后缀



管脚数目:

- A 8 脚
- B 10 脚
- C 12 脚
- D 14 脚
- E 16 脚
- G 24 脚
- M 48 脚

10.MICRO POWER SYSSYEMS

美国微功耗系统公司

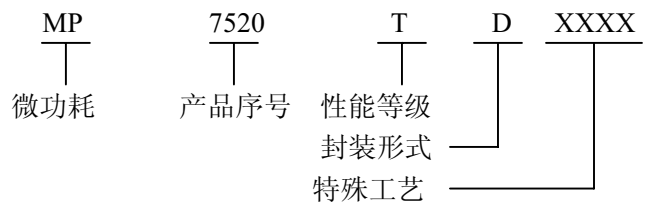
温度范围:

- J、K、L 商用/工业级
- S、T、U 军用级

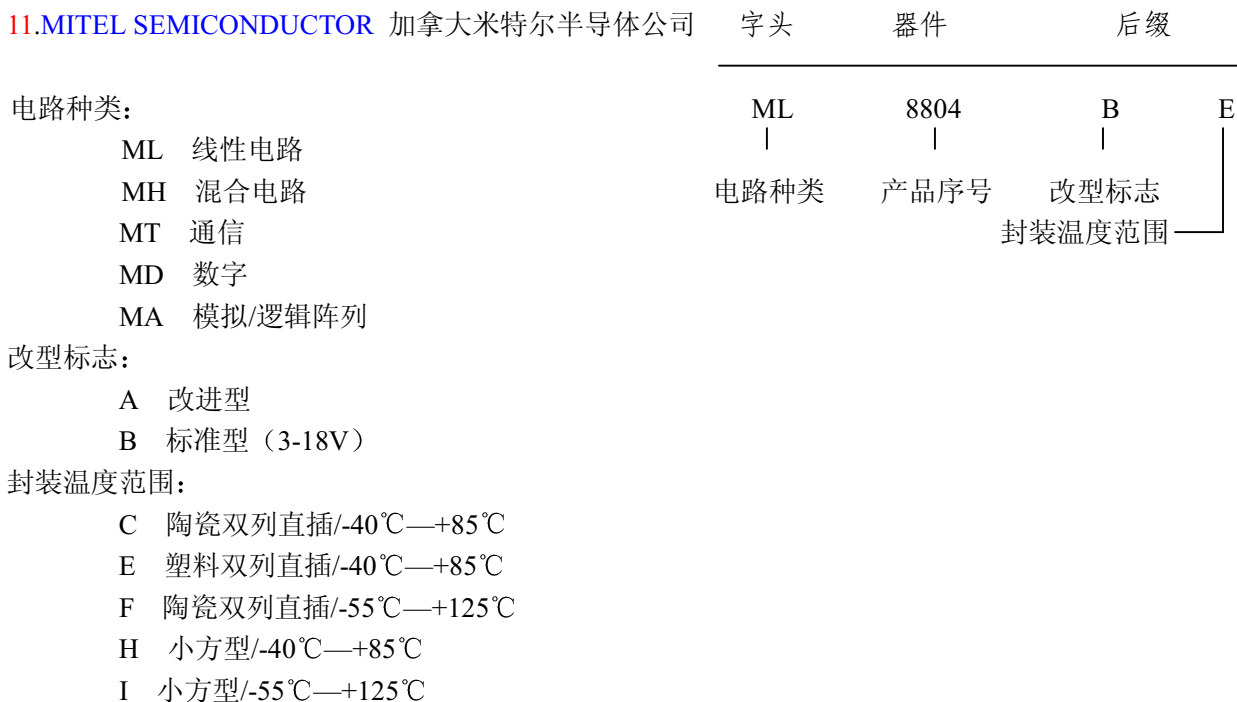
封装形式:

- D 陶瓷双列直插
- N 塑料双列直插
- II TO-100 金属壳

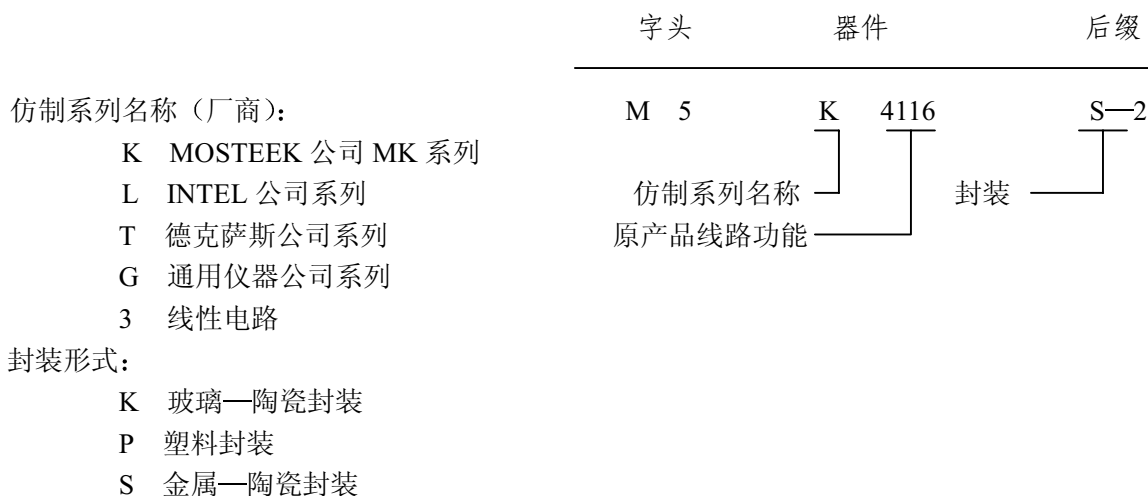
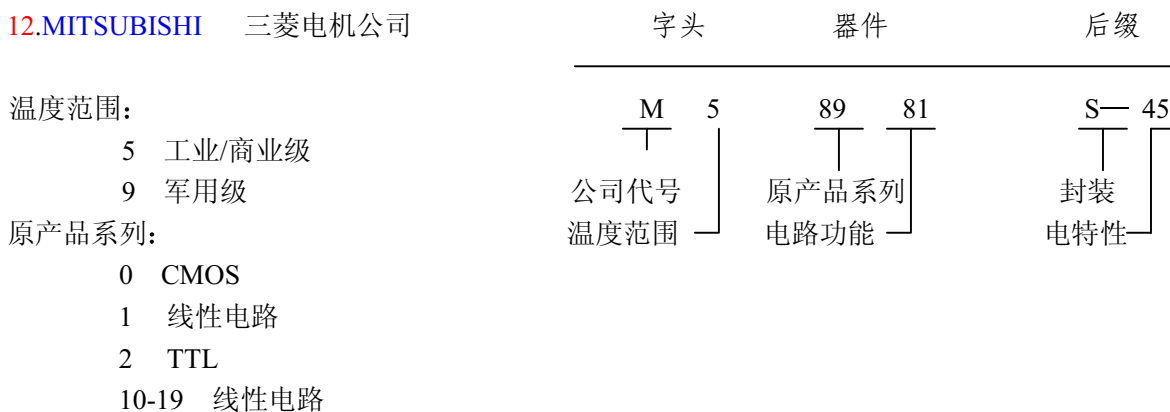
字头 器件 后缀



11. MITEL SEMICONDUCTOR 加拿大米特尔半导体公司



12. MITSUBISHI 三菱电机公司



13.MOSTEK 美国莫斯特卡公司

	字头	器件	后缀
封装形式:	MK	4116	P
E 陶瓷无引线芯片	└	└	└
J 陶瓷双列直插	公司代号	产品序号	封装形式
K 锡—铜封装 (陶瓷双列直插)			
N 塑料双列直插			
P 金—锡封装 (陶瓷双列直插)			
T 透明盖板 (陶瓷双列直插)			

14.MOTOROLA 美国莫托罗拉公司

	字头	器件	后缀
电路类别:	MC	3361	P
MC 已封装产品	└	└	└
MCC 未已封装芯片	电路类别	产品序号	封装形式
MCCF Flip—chip 线行电路			
MCM 存储器			(有些集成电路可能无商标表示)
LM 由国家半导体公司制造的电路			(一些仿制品采用原商标)
MMS 存储器系统			
封装形式:			
F 扁平陶瓷封装			
G 金属管封装 (TO-5)			
K 金属功率封装 (TO-3)			
L 陶瓷双列直插			
P 塑料封装			
T 塑料封装 (TO-220)			

15.NATIONAL SEMICONDUCTOR 美国国家半导体公司

	字头	器件	后缀
电路类别:	LM	386	X X
ADC 模/数转换	└	└	└ └
DAC 数/模转换	电路类别	产品序号	封装形式
LF 线性 (双极—场效应)			可靠性指标
LM 线性 (单片)			
TBA 线性 (仿制)			
TDA 线性			
(其它)			
温度范围:	温度范围:		
对于线性电路采用 1、2、3 数码标志			
1 军用级 (-55℃—+125℃)		D 玻璃/金属双列直插	
2 工业级 (-25℃—+85℃)		F 玻璃/金属扁平	
3 商用级 (-0℃—+70℃)		F00、01、F06、F07 标准引线玻璃/金属扁平	
(其他)		N 标准双列直插	
		W00、W01、W06、W07 标准引线玻璃/金属扁平	

16.NEC 美国电子公司 NECE 日本电气公司 NECJ

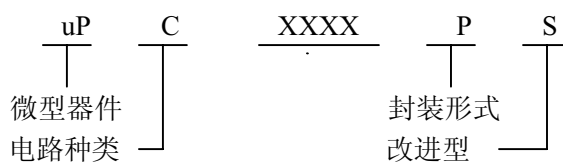
字头

器件

后缀

电路种类:

- A 分立元件
- B 数字双极器件
- C 线性电路
- D 数字 CMOS



封装形式:

- C 塑料封装
- D 陶瓷或陶瓷双极直插

17.PANASONIC 日本松下公司

字头

器件

电路种类:

- AN 模拟器件
- DN 数字双极
- M,J 开发型号
- MN MOS 电路



18.PLESSET 英国普利斯半导体公司

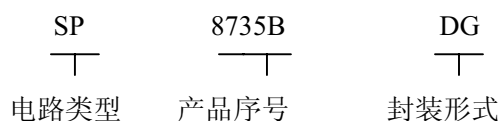
字头

器件

后缀

电路类型:

- MJ N 沟道 MOS
- ML MOS 线性 (带栅保护)
- MN MNMOS 数字
- MP MOS 数字
- MT MOS 线性 (不带栅保护)
- MV CMOS
- TAA、TBA、TDA、TCA 消费类电路
- SL 双极线性
- SP 双极数字 (其它)



封装类型:

- CM TI-5 金属圆壳
- DG 陶瓷双列引线
- DP 塑料双列引线
- QG 陶瓷四列引线
- QP 塑料四列引线
- SP 塑料单列

19.PRO ELECTRON

	字头	器件	后缀
电路类别:	TD A	386	P
数字电路 (字头前二位数)	TD		P
FA-FZ	电路类别	产品序号	封装形式
GA-GZ 系列电路	温度范围		
非系列电路: (字头第一位数)			
S 非系列电路			
T 模拟电路			
U 模拟/数字混合电路 (字头第二位数没有特别意义, H 为混合电路)			
温度范围:			
A 温度范围没有特殊规定	E -25°C—+85°C		
B 0°C—+70°C	F -40°C—+85°C		
C -55°C—+125°C	G -55°C—+85°C		
D -25°C—+70°C			

温度范围:

后缀为一个字母时

- C 圆柱形
- P 塑料双列
- D 陶瓷双列

后缀为两个字母, 第一个字母的含义

- C 柱形
- D 双列引线
- E 功率双列引线
- F 扁平 (两变引线)
- G 扁平 (四变引线)
- K 菱形 (TO-3)
- M 多重引线 (二, 三, 四列引线除外)
- Q 四列引线
- R 功率四引线 (带散热片)
- S 单列引线 (TO-127, TO-220)
- T 三列引线

后缀为两个字母, 第二个字母的含义

- C 金属—陶瓷
- P 塑料
- Q 四列引线
- F 扁平
- U 芯片
- G 玻璃—陶瓷

20.RCA 美国无线电公司

	字头	器件	后缀
封装形式:	CA	3120	B E
D 陶瓷双列直插封装	电路类型	标准型	改进型 封装形式
E 塑料双列直插封装			
F 陶瓷双列直插 (玻璃封装)			
K 陶瓷扁平封装			
Q 四引线塑料封装			
T TO-5			
电路类型:	改进型:		
CA 线性电路	A 改进型 可与原型互换		
CD 数字电路	B 改进型 可与原型, A 改进型互换		
CDP 微处理器	C 改进型		
MWS MOS			

21.SANYO	日本三洋半导体公司	字头	器件	后缀
电路类型:		LA	4100	
LA 双极线性		└	└	
LB 双极数字		电路类型	改进型	
LC CMOS				
LE MNMOS				
LM PMOS, NMOS				
STK 厚膜电路				

22.SGS—ATES SEMICONDUCTOR	SGS—亚蒂斯电子元件公司	字头	器件	后缀
H 高电平逻辑电路		TDA	1200	
HB、HC CMOS、		└	└	
L、LS 专用集成电路				
M MOS				
TAA、TBA、TCA、TDA 消费类线性电路				
字头符号由欧洲电子联盟“PRO ELECTRON”指定，可参阅 PRO ELECTRON				

23.SIEMENS	德国西门子公司	字头	器件	后缀
电路类型:		TDA	2030	
T 模拟电路		SDA	5010	
S 数字电路		UA A	170	
U 模拟数字混合电路		└		
温度范围:		电路类型		
A		温度范围		
B 0°C—+70°C				
C -55°C—+125°C				
D -25°C—+70°C				
E -25°C—+85°C				
F -40°C—+85°C				
G -55°C—+85°C				

24.SIGNETICS	美国西格尼蒂克公司	字头	器件	后缀
字头含义:		N	83S181	N
N, NE 0°C—+70°C		└		└
(8200 和 9300 为 0°C—+70°C)		温度范围		封装 (塑料双列)
JB, JS, S, SE -55°C—+125°C (军用)				
SA -40°C—+85°C				
SU -25°C—+85°C				
CA 仿 RCA 公司电路				

DS	仿国家半导体公司电路	字头	器件	后缀
LS		uA	723C	N
LM		电路类型	温度范围	封装 (塑料双列)
MC	仿国家半导体公司电路			
SC	MOS 微处理机			
SM	微系统			
SD	DMOS 产品			
SG	仿通用硅器件公司电路 (Silicon General)			
UA	仿仙童公司电路	字头	器件	后缀
ULN	仿史普拉格公司电路	JB	82S181	1
封装形式:		温度范围 (军用)	封装 (陶瓷直插)	
N	表示 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 8, 40 引脚塑料双列直插			
1	表示 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 8, 40, 50 引脚陶瓷双列直插 (其它)			

25.SPRAGUE ELECTRIC	美国史普拉格公司	字头	器件	后缀
电路类型: (A 系列)		ULN	1083	A
UC CMOS		电路类型	产品序号	封装
UD 显示器件		温度范围		
UG 霍尔效应器件				
UL 线性电路				
温度范围:				
N -25°C—+70°C				
S -55°C—+125°C				
X				
封装形式:				
A 塑料双列直插				
B 陶瓷双列直插				
D TO—99				
J TO—87				

26.TELEFUNKEN	德国德律风根公司	字头	器件	后缀
电路类型:		U	113	B
U 集成电路		电路类型 (专利器件)	产品序号	器件工艺
器件工艺:				
B 双极				
M MOS				
其它字头由欧洲电子联盟指定				

电路类型:

- RSN 辐射老化电路
- SBP 双极处理器
- SMC MOS 高可靠
- SN 标准字头
- SNM 高可靠 I 级
- SNA 高可靠 II 级
- SNC 高可靠 III 级
- SNH 高可靠 IV 级
- TL 线性电路

TMS MOS

温度范围: (多数器件)

- 52 系列 -25°C—+125°C
- 54 系列 -55°C—+125°C
- 55 系列 -55°C—+125°C
- 62 系列 -25°C—+85°C
- 72 系列 0°C—+70°C
- 74 系列 0°C—+70°C
- 75 系列 0°C—+70°C
- TF 系列 -40°C—+85°C
- TP 系列 -55°C—+125°C

封装形式:

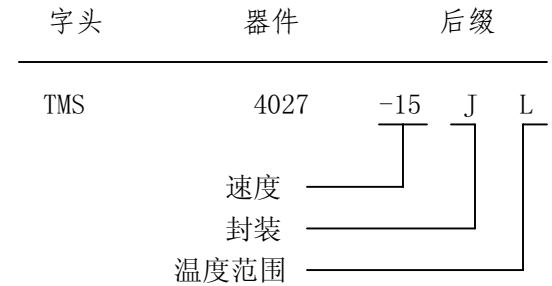
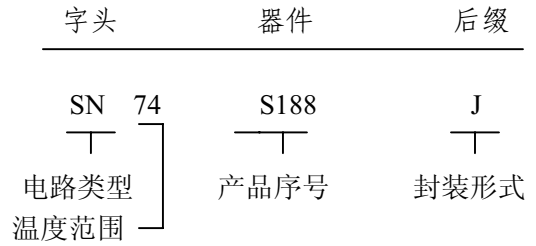
- FA 扁平
- J 陶瓷扁平
- JA, JB, JP 双列直插
- L, LA 金属管脚
- N 塑料双列直插
- ND, NE 塑料双列直插 (带散热片)

双极回缀:

- C 0°C—+70°C
- I -25°C—+85°C
- E -40°C—+85°C
- M -55°C—+125°C

MOS 回缀:

- L 0°C—+70°C
- C -25°C—+85°C
- R -55°C—+85°C
- M -55°C—+125°C



速度: (仅指 MOS)

- 15 150ns 最大存取时间
- 20 200ns 最大存取时间
- 25 250ns 最大存取时间

28.TOSHIBA 日本东芝公司

	字头	器件	后缀
电路类型:	TA	7176	AP
TA 双极线性	└─	└─	└─
TC CMOS	电路类型	产品序号	封装形式
TD 双极数字			
TM MOS			
封装形式:			
P 塑料			
M 金属			
A 改进型			
C 陶瓷			

29.TRW LSI PRODUCTS TRW 大规模集成电路公司

	字头	器件	后缀
电路类型:	TDC	1010	J M
MPY 乘法器	└─	└─	┌─┐
TDC 所有其它功能电路	电路类型	产品序号	封装
TD 双极数字			温度范围 └─┘
封装形式:			
J 陶瓷双列直插			
N 塑料双列直插			
温度范围:			
没有字母标志的为 0°C—+70°C			
M -55°C—+125°C			